

華泰電子股份有限公司

2026年法人說明會

股票代號 | 2329

02, OCT, 2026

簡報大綱

- 01 公司簡介
- 02 製造服務及產品
- 03 2026 Q2 營運成果
- 04 2026 Q4 及未來展望
- 05 Q & A



公司簡介



2026

資本額 Capital : US\$ 208M (NTD 6.59B)

成立滿55周年

2020

頤邦科技入股共同開發未來新製程

2015

三大記憶體客戶入股強化記憶體布局

2014

與客戶共同開發世界1st 16D microSD

2005

策略選擇進入記憶體市場發展

1994

公開發行上市

1971
創立

全台第一家封裝測試廠
創辦人：杜俊元博士
總部：高雄



Headquarters
(59,587 M²)



Production Building

6+1^o NTIP



Employee

5,800 人



LIC
(35,738 M²)



Facility 1
(11,251 M²)



***Launch Operation
by the 2nd Quarter
of 2027**



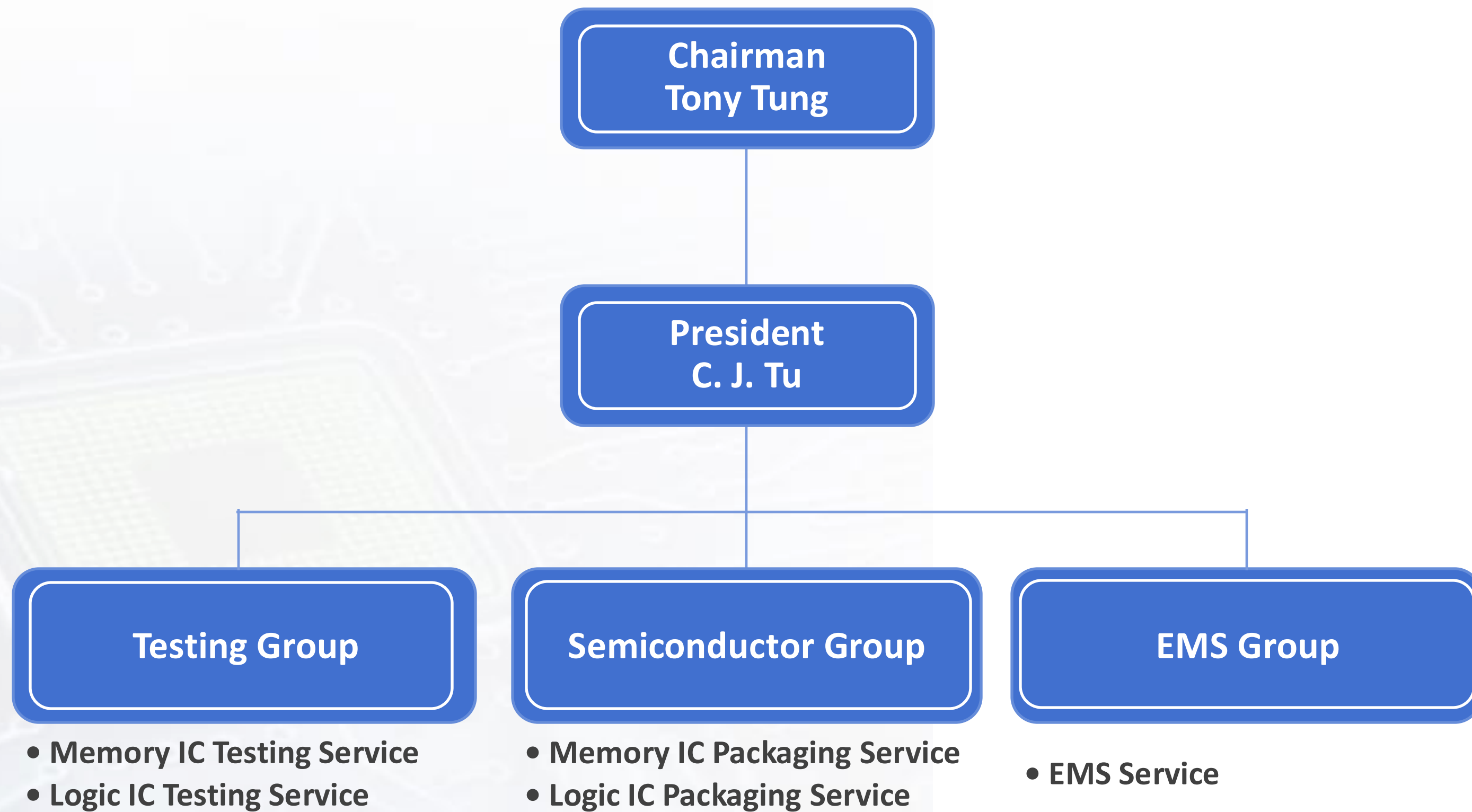
Facility 3
(15,691 M²)



Facility 2
(5,625 M²)



Facility 5 - EMS
(15,705 M²)



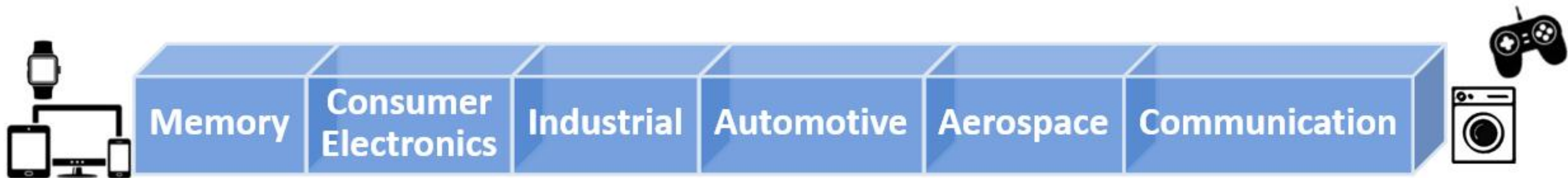
製造服務及產品

» IC Packaging & Testing Service



➤➤ Electronics Manufacturing Service





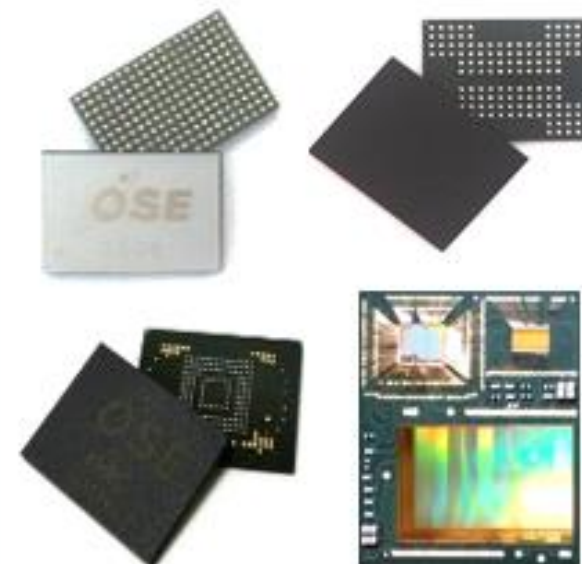
Leadframe



Flash Memory Card



CSP/eMMC/SiP



EMS



*Includes Wire Bond Type, Flip Chip Type, SiP, etc

2026 Q2 營運成果

合併綜合損益表 (與上一季比較)

(單位：新台幣仟元)	Q2/2026	%	Q1/2026	%	QoQ%
營業收入淨額	5,476,218	100.00%	4,860,476	100.00%	12.67%
營業毛利	725,559	13.25%	621,703	12.79%	16.71%
營業淨利 (淨損)	345,365	6.31%	272,602	5.61%	26.69%
稅前淨利 (淨損)	453,261	8.28%	291,646	6.00%	55.41%
所得稅利益 (費用)	(45,067)	(0.82%)	(57,016)	(1.17%)	(20.96%)
非控制權益	-	-	-	-	-
歸屬於本公司業主之淨利	408,194	7.45%	234,630	4.83%	73.97%
基本每股盈餘 (新台幣元)	0.62	-	0.33	-	-
EBITDA	756,929	13.82%	592,442	12.19%	27.76%

合併綜合損益表 (與去年同期比較)

(單位: 新台幣仟元)	Q2/2026	%	Q2/2025	%	YoY%
營業收入淨額	5,476,218	100.00%	5,263,888	100.00%	4.03%
營業毛利	725,559	13.25%	787,827	14.97%	(7.90%)
營業淨利 (淨損)	345,365	6.31%	419,883	7.98%	(17.75%)
稅前淨利 (淨損)	453,261	8.28%	409,022	7.77%	10.82%
所得稅利益 (費用)	(45,067)	(0.82%)	(21,829)	(0.41%)	106.45%
非控制權益	-	-	-	-	-
歸屬於本公司業主之淨利	408,194	7.45%	387,193	7.36%	5.42%
基本每股盈餘 (新台幣元)	0.62	-	0.54	-	14.81%
EBITDA	756,929	13.82%	669,705	12.72%	13.02%



重要資產負債表項目及財務指標 (與上一季比較)

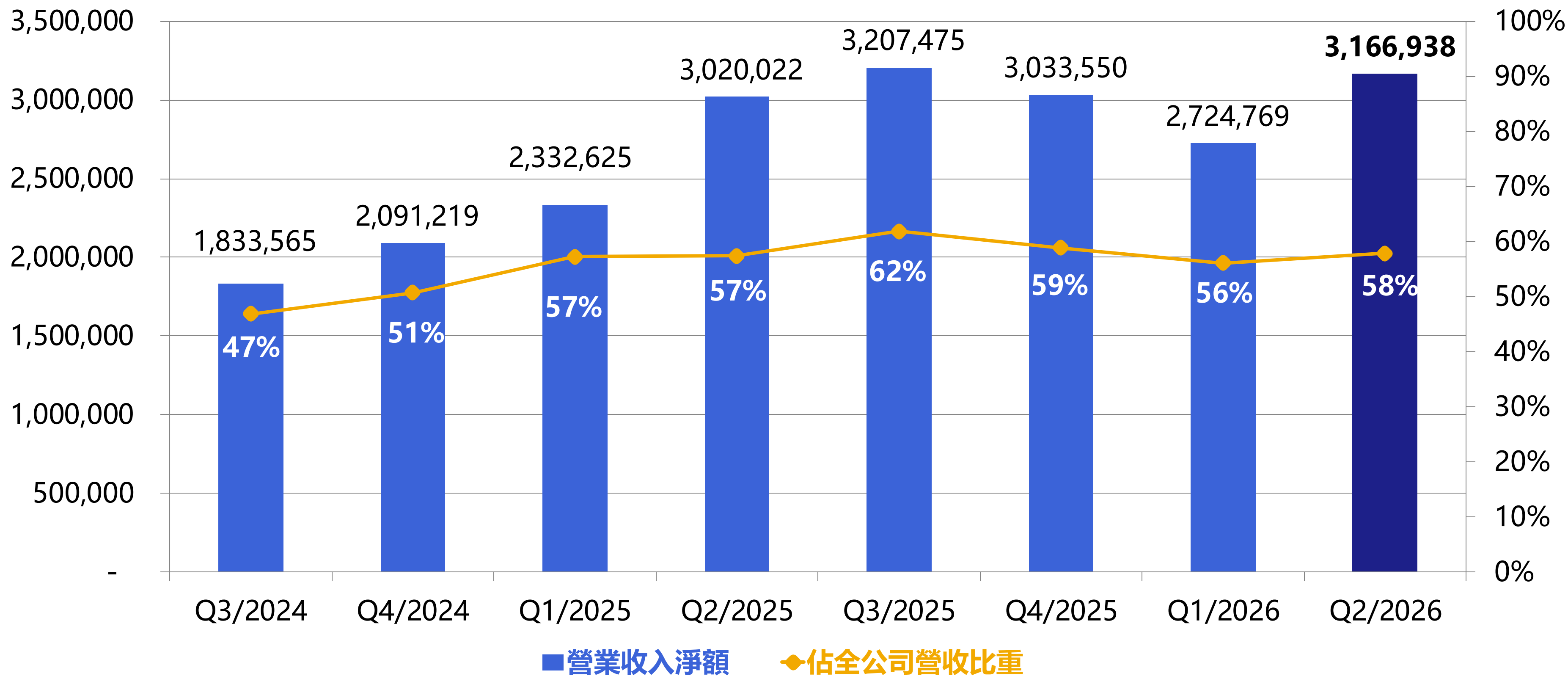
(單位: 新台幣仟元)	Q2/2026	Q1/2026	QoQ%
現金及約當現金	3,029,326	3,066,961	(1.23%)
金融資產-非流動及採用權益法之投資	6,630,744	2,346,166	182.62%
不動產、廠房及設備	8,961,961	8,432,023	6.28%
資產總計	26,654,758	22,594,916	17.97%
短期借款及應付短期票券	281,052	224,000	25.47%
一年或一營業週期內到期長期負債	147,336	184,002	(19.93%)
應付公司債	2,363,704	2,351,000	0.54%
長期借款	241,427	228,203	5.79%
負債總計	10,245,168	11,149,882	(8.11%)
權益總計	16,409,590	11,445,034	43.38%
當季EBITDA	756,929	592,442	27.76%
重要財務指標			
負債比率	38.44%	49.35%	
應收帳款週轉天數 (Q2)	74天	87天	
存貨週轉天數 (Q2)	48天	59天	

重要資產負債表項目及財務指標 (與去年同期比較)

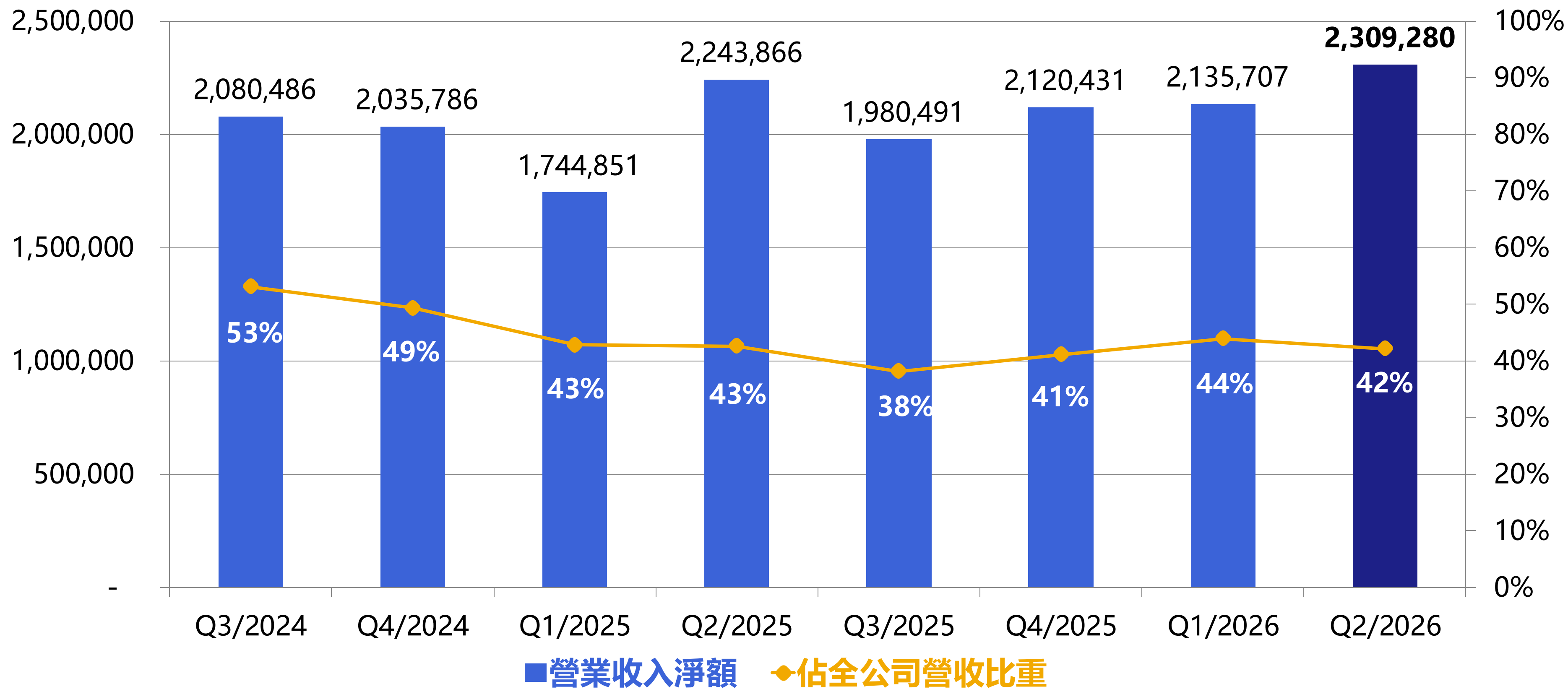
(單位：新台幣仟元)	Q2/2026	Q2/2025	YoY%
現金及約當現金	3,029,326	3,437,751	(11.88%)
金融資產-非流動及採用權益法之投資	6,630,744	1,441,800	359.89%
不動產、廠房及設備	8,961,961	6,982,388	28.35%
資產總計	26,654,758	20,317,276	31.19%
短期借款及應付短期票券	281,052	-	100.00%
一年或一營業週期內到期長期負債	147,336	465,872	(68.37%)
應付公司債	2,363,704	0	-
長期借款	241,427	897,925	(73.11%)
負債總計	10,245,168	9,163,846	11.80%
權益總計	16,409,590	11,153,430	47.13%
當季EBITDA	756,929	669,705	13.02%
重要財務指標			
負債比率	38.44%	45.10%	
應收帳款週轉天數 (Q1~Q2)	78 天	91天	
存貨週轉天數 (Q1~Q2)	51 天	39天	



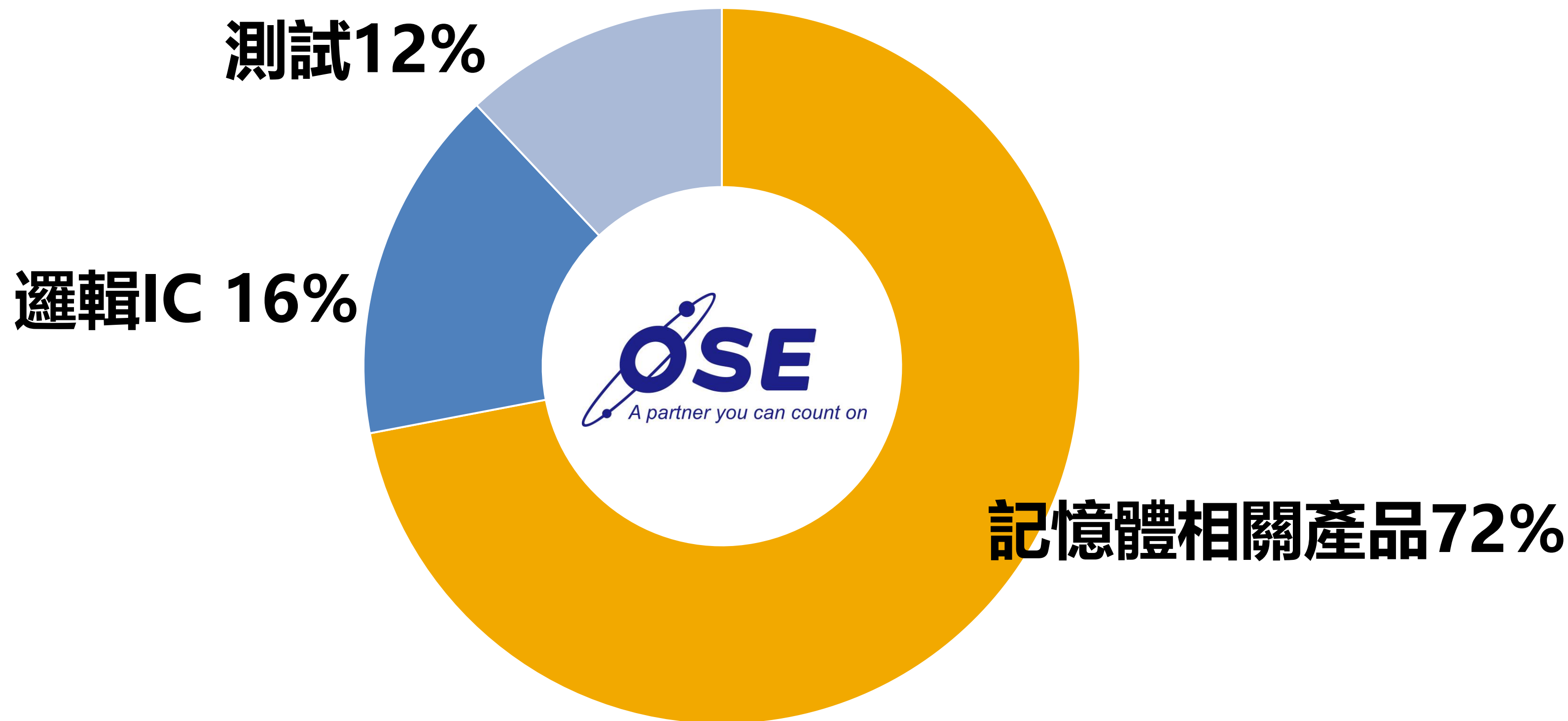
(單位：新台幣仟元)



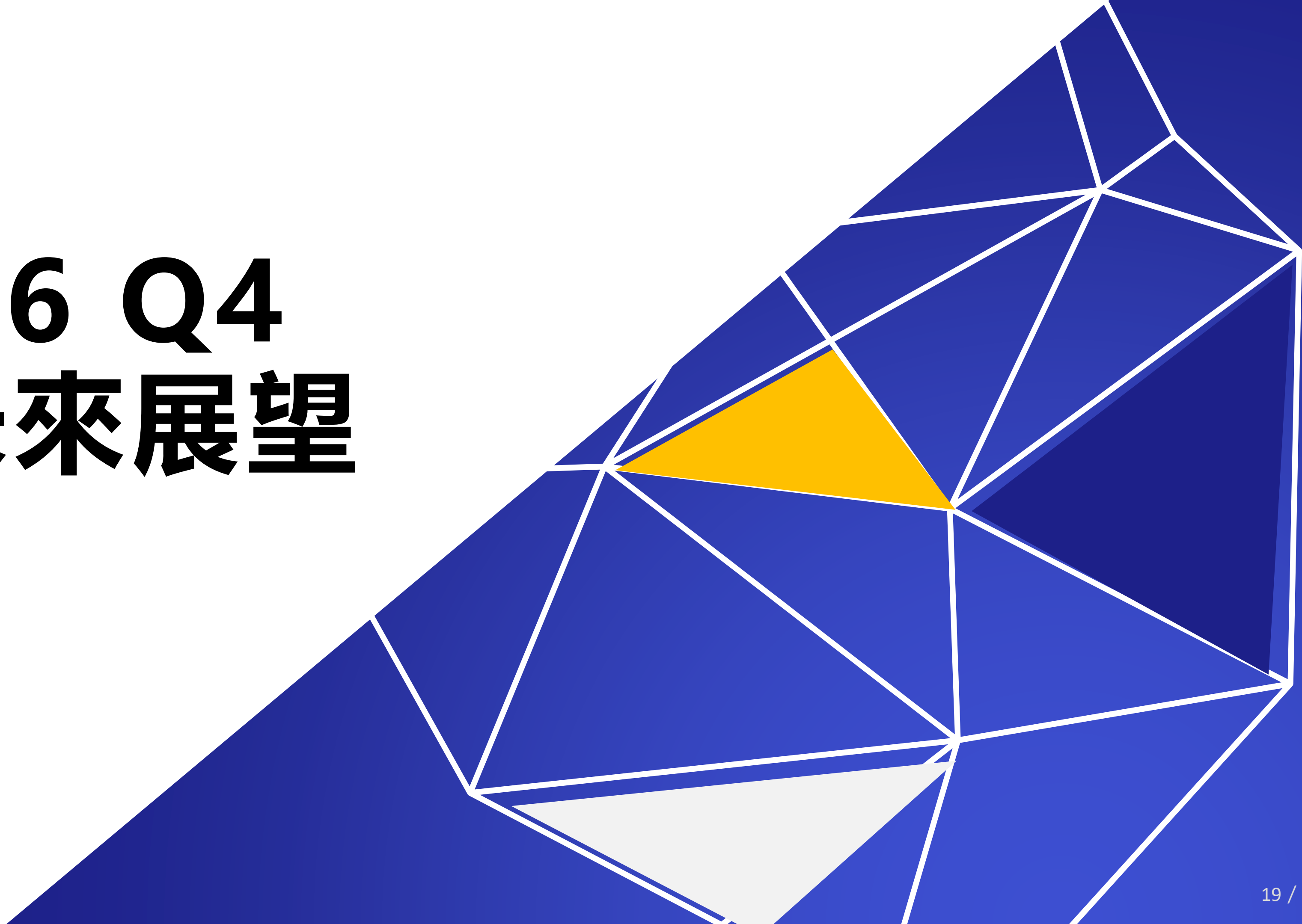
(單位：新台幣仟元)



[2026 Q2 半導體封測營收-產品應用別佔比



2026 Q4 及未來展望



2026 Q4

■ 記憶體產業：記憶體供需失衡

- 1 AI帶動記憶體需求結構失衡，影響消費性電子市場需求
 - 2 NAND需求結構由消費性電子，快速轉向以 AI Data Center 、企業級 SSD 、高容量儲存單元產品為主
 - 3 記憶體賣方市場態勢持續
-

IC

- 01 記憶體原廠客戶進入前十大，佔營收比重上升
 - 02 原廠低容量 eMMC End of Life，國內記憶體客戶下單積極
 - 03 Q2產能利用率約70%
-

EMS

- 01 AI 基礎建設熱潮持續，客戶訂單正面
-

未來展望

IC：記憶體供應鏈製造平台

- 原廠記憶體客戶比重持續上升，帶動業績穩健成長
- 企業級 SSD (eSSD for AI server, Data Center etc.) 開始出貨，提供 AI客戶 One-stop shopping: 從Wafer CP、封裝、測試及SMT 全製程服務。
- 國內記憶體客戶低容量 eMMC 需求強勁，訂單持續
- 邏輯 IC封測訂單外溢效應逐步展現
- Hybrid Bonding (w/b+ FC)：因應高速傳輸需求，高階記憶體產品 (e.g. microSD 7.0、eUFS 4.x、uSSD etc.)，為未來成長動能 (Memory + Controller System-in-Package, SiP)
- 未來佈局: Fan-Out FCCSP高階封裝 (與客戶合作開發中)

未來展望

EMS：AI客戶關鍵供應鏈



01

AI 客戶訂單 維持樂觀

02

企業級 SSD Memory Module 開始出貨給 AI 客戶，
成為明年成長動能

Q & A



感謝聆聽



The presentation and the relevant information mentioned in this material have been compiled from both internal and external resources.

These forward looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, including price variation, competition, global economy, exchange rate movement and market demand, which may cause actual results to differ materially from those implied by such forward-looking statements.

The forward looking statements expressed in this material reflect the Company' s current view about the future as of today. The Company is not responsible for any updates if there are any changes in the future.